



CFP

TE 内部编号 2057629-1

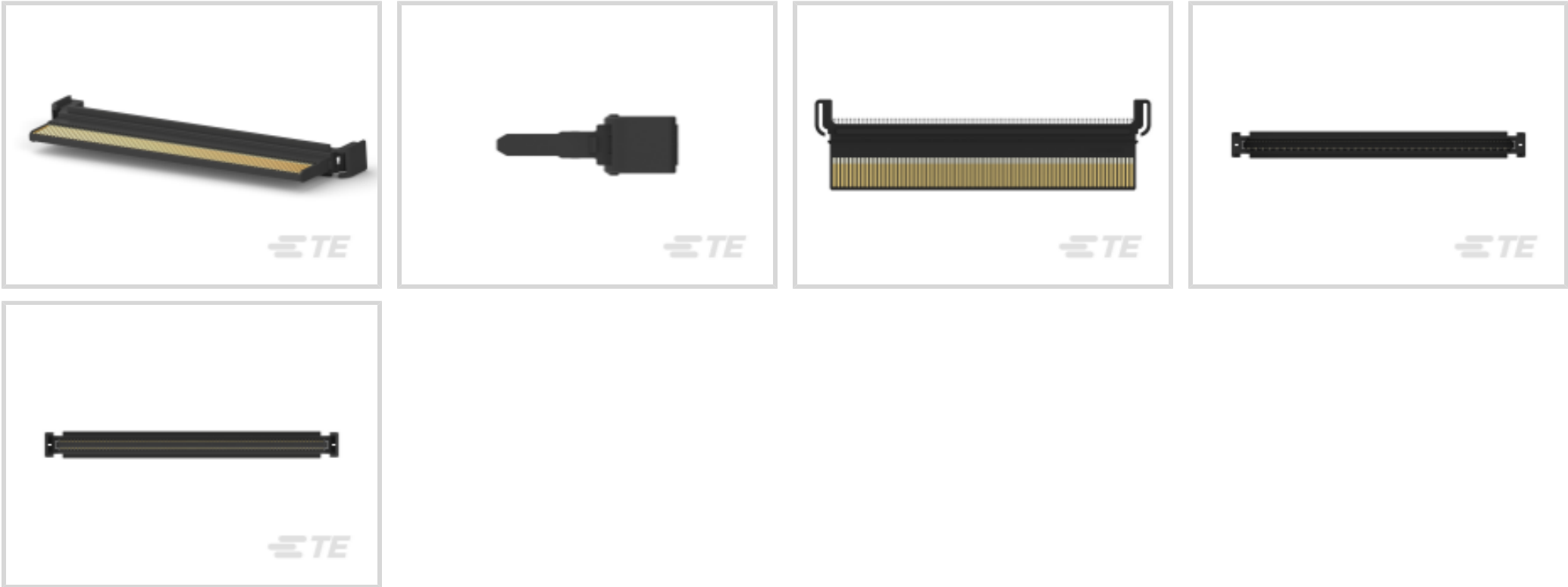
CFP, CFP/CFP2/CFP4, Connector, Port Matrix Configuration 1 x 1,

Data Rate (Max) 100 Gb/s, Straddle Mount, Board-to-Board, 148

Position

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式连接器和笼子 > CFP/CFP2/CFP4



插拔式 I/O 产品类型: 连接器

端口矩阵配置: 1 x 1

数据速率（最大值）：100 Gb/s

PCB 安装方式: 跨接安装

连接器系统: 板对板

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	CFP
产品线	CFP
插拔式 I/O 产品类型	连接器
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

端口矩阵配置	1 x 1
Number of Positions	148

电气特征

数据速率（最大值）	100 Gb/s
-----------	----------

主体特性

电镀材料	金
------	---



机械附件

PCB 安装方式	跨接安装
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
---------	----------------

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.44 mm[.057 in]
------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

适用于插拔式 I/O 产品	CFP 组件
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2057630-1
CFP Receptacle Conn Assy

该系列中的其他产品 | CFP

CFP/CFP2/CFP4(22)

客户还购买了

TE 产品编号1489951-1
XFP CAGE ASSEMBLY

TE 产品编号1367500-1
30 POSN XFP CONN, ENHANCED

TE 产品编号1565079-1
GRACE INERTIA 3.5 REC CONTACT(L)

TE 产品编号927837-5
SPT REC 6.3 Contact SRC Ag

TE 产品编号106137-2
Z-PACK/A SHRD.110P

TE 产品编号1551892-1
Cage Assy Behind Bezel QSFP28

TE 产品编号120591-1
TOP LOAD BATTERY

TE 产品编号1489948-2
XFP HEAT SINK CLIP, PLATED



文档

产品图纸

[CFP Module Conn Assy](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2057629-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2057629-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2057629-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[CFP_40G_100G_ETHERNET_CONNECTORS](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

[MD_2057629-1_10092015740_dmtec](#)

英文版本

[MD_2057629-1_10092015740_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)



英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本